



# bCOM6-L1400

## Модуль COM Express повышенной надежности

Компания GE Intelligent Platforms хорошо понимает, что длительные циклы разработки и высокая стоимость запуска новой продукции мешают OEM-производителям создавать сетевое и компьютерное оборудование, обладающее новейшими технологическими характеристиками.

Для решения этих задач, компания GE Intelligent Platforms разработала модуль bCOM6-L1400. Он обладает всеми преимуществами последнего поколения процессоров Intel® Core™ i7: расширенными возможностями по видеообработке, турбо-ускорением и контролем за подачей питания. В результате модуль bCOM6-L1400 идеально подходит для широкого спектра коммерческих, промышленных, транспортных и оборонных приложений в разнообразных встраиваемых вычислительных системах. Применение этого высоконадежного модуля COM Express сокращает общий цикл разработки и расходы на запуск новой продукции, снижая тем самым общую стоимость владения.

### Лучшие в своем классе надежность и производительность

Модуль bCOM6-L1400 от GE Intelligent Platforms является лучшим представителем нашей линейки устройств COM Express. Он предлагает наивысшую производительность и исключительную надежность, которые необходимы приложениям, работающим в неблагоприятных условиях. Модуль bCOM6-L1400 предназначен для приложений с несколькими графическими функциями или высокими вычислительными потребностями. Как и все наши модули Туре 6, bCOM6-L1400 оборудован процессором последнего поколения.

Установленные на плате компоненты были специально отобраны по своим характеристикам для работы в сложных условиях. В отличие от стандартных решений, наши процессор и память запаяны в плату для обеспечения максимальной стойкости к ударам и вибрациям. Модуль защищен усиленной механической конструкцией. В качестве опции доступно защитное покрытие, обеспечивающее дополнительную стойкость к влаге, пыли, химикалиям и экстремальным температурам.

### Увеличенный срок службы и меньшие расходы

Архитектура COM Express делает процессор и плату-носитель независимыми друг от друга. Это продлевает срок службы системы, обеспечивая простую модернизацию путем замены только процессора. При этом сокращаются эксплуатационные расходы в течение срока службы, а производительность увеличивается в соответствии с изменяющимися потребностями.

### Обязательства перед клиентами

Современные компании работают в условиях ограниченного бюджета, их инженерные ресурсы ограничены, а время продвижения на рынок играет критическую роль. Поэтому в дополнение к исключительной производительности и высоким эксплуатационным качествам модулей COM Express, компания GE Intelligent Platforms предоставляет в распоряжение заказчиков свой богатейший опыт в данной области. Чтобы помочь вам быстрее выйти на рынок и уменьшить стоимость разработки, мы окажем помощь вашим проектировщикам или создадим для вас индивидуальное решение.

Функциональные особенности	Преимущества
Усиленная конструкция с паяными компонентами	<ul style="list-style-type: none"> <li>Надежность вычислений в приложениях, требующих повышенной стойкости к ударам и вибрациям</li> </ul>
Многоядерные процессоры Intel Core i7 нового поколения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальная производительность при малом энергопотреблении</li> <li>Поддержка нескольких графических дисплеев</li> </ul>
Динамическая защита от перегрева	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контролируемая система отключается по сигналу датчиков температуры по избежание повреждения вследствие перегрева</li> <li>Экономия средств за счет возможности лабораторного моделирования перед эксплуатационными испытаниями</li> </ul>
Гибкие опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дополнительная защита от ударов и вибраций</li> </ul>



# bCOM6-L1400 – Модуль COM Express повышенной надежности

## Технические характеристики

### Процессор

- Intel® Core™ i7, паянный
  - 4-ядерный i7 35 Вт (SV)
  - 2-ядерный i7 25 Вт (LV)
  - 2-ядерный i7 17 Вт (ULV)

### Чипсет

- Intel Panther Point PCH

### Память

- До 8 ГБ DDR3, с ECC
- Паянная

### Графические функции

- Встроенный графический интерфейс
  - 1 интерфейс VGA
  - 1 канал SDVO поверх DDI
  - TMDS поверх DDI
  - Display port поверх DDI
  - 1 интерфейс LVDS с поддержкой двух каналов

### Звук

- Поддержка HDA

### Сетевой порт

- 1 порт Gigabit Ethernet

### Интерфейс Serial ATA

- Поддержка 4 интерфейсов Serial ATA, совместимых со спецификацией SATA 1.0
- Поддержка устройств SATA-II со скоростью до 3 Гбит/с
- Поддержка двух устройств SATA-3 со скоростью до 6 Гбит/с
- Поддержка RAID 0 и RAID 1

### Интерфейс USB

- 8 портов USB 2.0
- 4 порта USB 3.0

### Прочее

- Состояния: S0, S1, S2, S3, S4, S5 (S3 зависит от дежурного питания 5 В)
- Порт для расширенной отладки
- Датчики сигнализации температуры чипсета
- Радиатор/теплопровод для оптимизации охлаждения

### Слоты расширения

- 1 слот PCIe Graphics (PEG) x16 или 2 слота x8 Gen 3
- Каналы PCIe 0-6: 7 каналов x1 или 1 x4 Gen 2

### Интерфейс ввода/вывода

- 8 портов GPIO или интерфейс карты SD

### Питание

- Вход: 12 В, питание в дежурном режиме 5 В

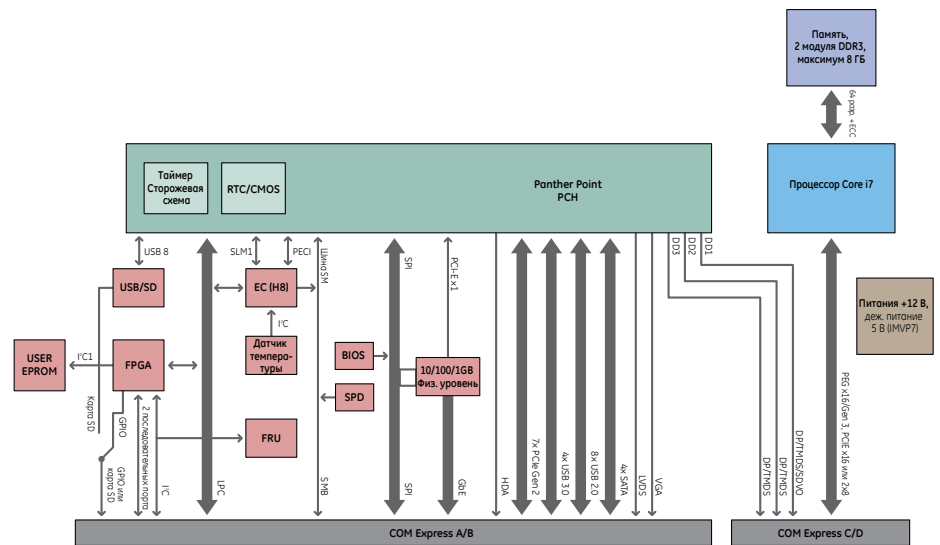
### Условия окружающей среды

- Рабочая температура: от 0 °C до +65 °C (стандартный диапазон)
  - Рабочая температура: от -40 °C до +85 °C (расширенный диапазон; зависит от модели ЦП)
  - Температура хранения: от -40 °C до +125 °C
  - Рабочая относительная влажность воздуха: от 10 % до 90 %
- Примечание:** максимальный диапазон рабочих температур зависит от выбранного процессора.

### Стойкость к ударам/вибрациям

- Повышенная стойкость к ударам и вибрации; зависит от конструкции платы-носителя/системы

## Структурная схема



### BIOS

- UEFI
- Интерфейс SPI

### Печатная плата

- Габаритные размеры: 95 мм x 125 мм
- Базовый форм-фактор: COM Express
- Совместимость: PICMG COM Express R2.0

### Поддерживаемые операционные системы

- Microsoft® Windows® XP, Windows 7, Linux®, VxWorks®

### Опции

#### Повышение прочности

- Конформное покрытие
- Уровень А и F
  - Удары: 20 г, 11 мс
  - Вибрации: 5 - 100 Гц, 0,04 г<sup>2</sup>/Гц, 60 минут по каждой оси

## Информация для заказа

### BC6L114E62Z20A

2 ядра 1,3 ГГц, память 4 ГБ, стандартный диапазон температур

### BC6L114E62Z2HF

2 ядра 1,3 ГГц, память 4 ГБ, расширенный диапазон температур

### CEC02

Стандартная плата-носитель плата COM Express (без модуля COM Express)

## О компании GE Intelligent Platforms

GE Intelligent Platforms, входящая в состав компании General Electric (NYSE: GE) – высокотехнологичная компания, являющаяся мировым поставщиком оборудования, программного обеспечения и услуг в области автоматизации и встроенной вычислительной техники. Мы предлагаем своим заказчикам сверхнадежные и технически совершенные решения, построенные на самых современных технологиях и обеспечивающие существенные преимущества в таких сферах деятельности как: энергетика, водоснабжение, производство потребительских товаров, телекоммуникации, оборона и правительственные организации. Международная компания GE Intelligent Platforms входит в состав компании GE Energy Management. Штаб-квартира находится в Шарлоттсвиле, Вирджиния.

Подробнее см. на сайте [www.ge-ip.com/ru](http://www.ge-ip.com/ru)

## Контактная информация компании GE Intelligent Platforms в России и странах СНГ

Тел.: +7 495 739 6860

Телефоны региональных представительств указаны на нашем вебсайте [www.ge-ip.com/contact](http://www.ge-ip.com/contact)

[www.ge-ip.com](http://www.ge-ip.com)

2011 GE Intelligent Platforms, Inc. Авторские права защищены.

Все указанные в настоящем издании наименования и товарные знаки являются собственностью своих владельцев.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

07.12 GFA-1916

